

# 基于ZnO纳米结构的紫外光发射器 件及忆阻器件研究

刘益春

# 东北师范大学 物理学院 紫外光发射材料与技术教育部重点实验室

研究方向

#### 紫外光发射材料与技术教育部重点实验室



生命

光/电存储材料与器件
 <表面等离子体全息光存储</li>
 <氧化物薄膜阻变型存储器</li>
 <忆阻器与人工神经网络模拟</li>

微纳敏感材料与器件 <微纳单晶FET气敏器件 <纳米纤维气敏材料与器件 <磁性/发光/拉曼生物检测材料



## <del>纳米材料——优异的光/电特性,独特的物理/化学性质</del>





### (一) 基于ZnO纳米线的紫外LED/LD器件

### ❖研究背景与思路

### ◆研究工作

一纳米线异质结的设计

-LED/LD器件的构筑

-器件效率的改善

### (二) 基于ZnO纳米薄膜的忆阻器件

**◇**研究背景与思路

### **◇**研究工作

-ZnO阻变性能的改善---材料(合金化)、结构(局域电场) -基于ZnO化阻器的神经突触器件



### 短波长光发射器件



# UV light-emitting material promising candidate-----ZnO

Wide band gap 3.37 eV High exciton binding energy (60 meV) High optical gain coefficient (320 cm<sup>-1</sup>) Low growth temperature Available single-crystalline substrate Environment-friendly .....







P-type困难:	自补偿效应强、
	受主固溶度低、
	受主离化能大
	稳定性



### **Stability of p-type ZnO**



Appl. Phys. Lett. 92, 052106 (2008)



Thermal

Peak	N 1s	assignment (reference)	Our assignment	Stabilities
1	~396 eV	N-Zn bond or N <sub>O</sub> <sup>(7-11)</sup> , polarized triply bounded CN <sup>(16)</sup> , N-O <sup>(17)</sup>	N-Zn at <i>nitrogen</i> <i>rich</i> environment	unstable
2	~398 eV	N-Zn bond or N <sub>O</sub> <sup>(2, 13,14,16-18)</sup> , C-N species <sup>(7)</sup> , N-H <sup>(9, 10)</sup>	N-Zn at <i>oxygen</i> <i>rich</i> environment	Stable to 723 K
3	~400 eV	C-N species <sup>(7, 10, 16)</sup> , N-H <sup>(13,14,16)</sup> , oxynitride <sup>(8)</sup>	-NO species	unstable
4	~402 eV	(N <sub>2</sub> ) <sub>0</sub> <sup>(7, 10, 14, 16)</sup> , nitrite <sup>(2, 8)</sup>	(N <sub>2</sub> ) <sub>0</sub>	unstable



#### Appl. Phys. Lett. 95, 191903 (2009)

# 研究思路



# 研究工作--ZnO纳米线异质结构



# 研究工作--ZnO纳米线异质结构



<u>Appl. Phys. Lett. 102, 031905 (2013)</u> J. Alloy. Compd. 513, 399 (2012)

# 研究工作--ZnO纳米线异质结构

$$\frac{1}{d_{(hkl)}^{2}} = \frac{h^{2} + k^{2} - 2hk\cos\gamma}{a^{2}\sin^{2}\gamma} + \frac{l^{2}}{c^{2}}$$

$$\sigma = -\frac{Y}{\nu} \frac{d_{\text{(hkl)}} - d'_{\text{(hkl)}}}{d'_{\text{(hkl)}}}$$

$$\Delta E_{\text{stress}} = a_0^{\Gamma} (\ln V - \ln V_0)$$





Appl. Phys. Lett.	<i>102</i> ,	031905	(2013)
J. Alloy. Compd.	<u>513,</u>	399 (201	<u>(2)</u>

Sample	<i>a</i> /Å	<i>c</i> /Å	γ / Å	$\Delta E_{\rm g}$ /meV	$\Delta E_{ m stress}$ /meV
1	4.255	4.190	88.76	1031	184
2	4.244	4.174	88.66	1163	257
3	4.232	4.140	88.44	1281	370

# 研究工作--平面LED器件

### p-GaN/i-ZnO/n-ZnO异质结ZnO UV LEDs

#### *p*-type: Si, NiO, GaN, organics, etc.



### 研究工作--纳米线LED器件



## 研究工作--纳米线LED器件稳定性

### ZnO 纳米线 LED的稳定性?



稳定性研究: 在环境空气中 存放一年监测其电致发光随 暴露时间变化

辐射(非辐射)复合效率迅 速降低(增加),其中辐射 复合部分中紫外(可见)发 射效率迅速降低(增加)。



<u>Appl. Phys. Lett. 100, 203101 (2012)</u>



# 研究工作--器件: 纳米线器件稳定性



Appl. Phys. Lett. 100, 203101 (2012)

# 研究工作--纳米线LED器件稳定性改进



<u>Appl. Phys. Lett. 100, 203101 (2012)</u>

# 研究工作--纳米线LD器件

### ZnO/MgO核壳纳米线MIS异质结LD



Appl. Phys. Lett. 99, 063115 (2011)

# 总体思路



# 研究工作--LSP增强型LED器件

Surface Plasmon: collective oscillation mode of electrons at metal/dielectric interface



Evanescent wave: Decay with the distance from the metal surface



Spectral enhancement: fluorescence spectrum, Raman spectrum and nonlinear optical effect.

### 研究工作--器件: LSP增强型LED器件



研究工作--器件: LSP增强型、平面LED器件

### Ag LSP增强的p-GaN/i-ZnO/n-ZnO异质结LED







Appl. Phys. Lett. 101, 142101 (2012)

# 研究工作--LSP增强型、平面LED器件



### 研究工作--LSP增强型、纳米线LED器件



### 研究工作--LSP增强型、纳米线LED器件

### Ag 纳米粒子LSP增强的 ZnO纳米柱阵列LED



# 研究工作--器件: LSP增强型、纳米线LED器件

### Exciton-LSP 近场耦合增强 ZnO近带边EL



### 研究工作--器件: LSP增强型、纳米线LED器件

EL空间分布展宽: LSP-exciton coupling, LSP isotropic scattering



# 研究背景

### <u>阻变存储器 Resistive random-access memory (RRAM or ReRAM)</u> ---下一代非挥发性存储器? (FeRAM、MRAM、PCRAM、RRAM)

<mark>存 储 器</mark> 类型ℯ	NOR闪存。	NAND 闪存。	铁电存储器₽	磁阻存储器₽	相受存储器。	<b>阳安存储器</b> 。
单元。 元件。	1T₽	1T₽	1T1C#	1T1R₽	1T1R₽	ITIR/1D1R₽
单元+ 面积+	9−11F <sup>2</sup> ¢	5F <sup>2</sup> +2	12-22F <sup>2</sup> +2	$6$ -16 $F^2 \phi$	5-16F <sup>2</sup> ¢	5-8F <sup>2</sup> +2
读电压。	2⊽₽	2v¢	0.9v−3.3v+)	1.5v₽	3⊽+2	0.4v₽
读时间。	10ns¢	50ns¢	45ns₽	20ns≠	60ns#	<10ns+2
写电压₽	7−9v+	15v+²	0.9−3.3v¢	1. 5v₽	3⊽+2	0.5v−1v+²
写时间₽	1us/10ms≓	1ms/0.1ms₽	10ns₽	20ns₽	50/120ns₽	5−10ns¢
写能量↔	>1e-14¢	>1e-14+2	>3e-14₽	>1.5e-10₽	≻6e-12¢	>1e-12₽
读写↓ 次数↓	>1e5₽	>1e5₽	≻1e14@	≻1e16+2	>1e9₽	`>1e6₽
保持。 时间。	10年~	10年~	10年~	10年~	10年~	10年~
评论≠	/e	e	与 CMOS 工艺 不兼容,存 储密度较小↔	与 CMOS 工艺 不兼容,写 操作功耗大↩	与 CMOS 工艺 不兼容,写 操作功耗大↩	与 CMOS 兼容。 住好,研究时 间短,物理机 理不明确。

Parameter	Typical Flash	Target values	
Switching element size (nm)	100×100 cells	50×50	
Switching time (ns)	>10,000	10 to 50	
Set voltage (V)	18-20	2 to 4	
Reset voltage (V)	>5	-3 to -5	
Read voltage (V)	0.1 to 0.5	0.1 to 1	
Read current (A)	1×10 <sup>-6</sup>	1×10 <sup>-6</sup>	
Switching energy (pJ/bit)	410-1,010 <sup>(1)</sup>	<0.5	
Device yield	>99%	>99%	
Endurance	$10^3$ to $10^7$	$10^5$ to $10^6$	
Resistance ratio	N/A	$10^5$ to $10^6$	

#### RRAMの動作特性 (動作電流・速度)



# 研究工作-ZnO基忆阻器件

<u>ZnO材料</u>:可调控的电学性质、可调控的薄膜结晶状态、

可充当离子导体、制备手段多样......



### 研究工作——高速ZnO RRAM器件

引入Ag纳米晶层 —— 参数均一 + 高速转变(20ns/30ns)



Nanoscale 5, 4490 (2013)

## 研究工作——高速ZnO RRAM器件



Nanoscale 5, 4490 (2013)

# 研究工作—透明柔性ZnO基 RRAM器件



Crystalline



Amorphous



In 5s 球 形轨道 交叠大





### 研究工作—透明柔性ZnO基 RRAM器件



大角度弯折及10<sup>5</sup>次弯折下器件运行稳定

Flat

U-shape

After bending

Voltage(V)

Resistance(ohm)

Bending cycles

### 柔性及可见透过率



IEEE Electron Device Letters 32, 1442 (2011)

忆阻器: Memristor =<u>Memory</u>+<u>Resistor</u> 未来发展*:即开型PC、模拟式计算机、人工智能-----*1971年,蔡少棠,《忆阻器:下落不明的电路元件》 2008年,HP公司,《The Missing Memristor found》



#### <mark>忆阻器</mark>:电阻阻值随流过的电荷量 发生改变,并能够记住阻值的变化。



神经突触: 连接状态随流经的 离子而发生变化。

器件结构











艾宾浩斯记忆规律









### 研究工作—p-n结器件的基本忆阻特性



# 研究工作—p-n结器件的基本忆阻特性



### 研究工作—p-n结器件的基本忆阻机制研究



IGZO双层忆阻器

$$\mathbf{I}(\mathbf{t}) = \mathbf{I}_0 + \mathbf{A}_1 \mathbf{e}^{(-\mathbf{t}/\tau)}$$

20-40s的弛豫时间可能由于 浓度差引起的氧离子回扩散。

p-n结忆阻器

 $I(t) = I_0 + A_1 e^{(-t/\tau_1)} + A_2 e^{(-t/\tau_2)}$ 

慢的弛豫过程可能来源于氧的浓度差 快的弛豫过程可能来源于内建电场

p-n结忆阻器会有不同的机制



 $dC^{-2}$  $q\varepsilon_0\varepsilon_r N_{\rm D}A^2$ dφ

势垒层主要在p-CuA10<sub>2</sub>一侧

势垒宽度同时 引起电阻、势 全电容变化



### p-n结势垒电容

$$C_T = A \epsilon_r \epsilon_0 / X_D$$

因此: 正偏压下,势垒区变窄,电阻减小, 反偏压下,势垒区变宽,电阻增加。



$$X_{D} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{r}\varepsilon_{0}(N_{A} + N_{D})(V_{D} - V)}{qN_{A}N_{D}}}$$

器件电阻集中在p-n结 处,因此电场主要加 在p-n结势垒区,导致 电场实际上在调节势 垒宽度。

正向偏压,CuAlO<sub>2</sub>一侧Cu空位N<sub>A</sub>增加,ZnO一侧氧空位N<sub>D</sub>增加, 使势垒区宽度X<sub>D</sub>减小。器件电阻R减小。

反向偏压,CuAlO<sub>2</sub>一侧Cu空位N<sub>A</sub>减小,ZnO一侧氧空位N<sub>D</sub>减小,使势垒区宽度X<sub>D</sub>增加。器件电阻R增加。

p-NiO/n-ZnO异质结构 对忆阻原因进行研究



400度生长的p-n 结器件容易开启, 而室温ZnO/NiO 结构在-5V到5V 的范围内并没有 被开启,我们认 为这只是对势垒 宽度的调节所导 致的电流增加。



 $dC^{-2}$  $q\varepsilon_0\varepsilon_r N_{\rm D}A^2$ dφ 由于室 原因: 温生长时,结 晶性相对差, 又没有外延关 系,氧离子在 薄膜生长的过 程中由富氧NiO 一侧向缺氧 ZnO一侧扩散, 导致两边杂质 浓度降低。

400度生长的六角相ZnO的(002)峰与400度生长的立方相NiO的(111)峰有外延关系。



室温生长的p-n结器件展示了忆阻行为,同时实现了 对电容的记忆,而400度下的器件无忆阻行为。

使用非晶材料,或者降低的结的质量,有利于氧 离子在势垒区迁移,更加利于实现忆阻行为。



为研究设计忆容器提供一种思路

总结

### (一) 基于ZnO纳米线的紫外LED/LD器件

材料——纳米线异质结构(ZnO/MgZnO、MgZnO/MgO径向/轴向异质结) 器件——PIN、MIS异质结(p-GaN/i-ZnO/n-ZnO:Al、Au/MgO(SiO<sub>2</sub>)/ZnO等) 性能改善—稳定性、效率(纳米结构&LSP的引入、外延包覆)

### (二) 基于ZnO纳米薄膜的忆阻器件

材料改性—掺杂、合金化、复合体系…

结构改进—纳米结构增强电场、多层结构···(目标:转变位置的可控性)

**原理探索**—离子迁移扩散、原子开关、pn结空间电荷区宽度调制、界面势垒···

感谢国家863、973计划,国家基金委重点基 金等项目的大力支持!感谢研究组老师、研 究生的努力工作!

